



RE900-03

- Fibre de verre FR4 époxyde 1,50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique et un laque d'arrêt de soudure
- Platine d'adaptation pour TSOP I 20, 24 (0,50 mm)
- Perforation 1,00 mm Ø
- Les données Data Gerber d'apprêt pour l'établissement de l'application de pâte à braser seront mis à la disposition gratuitement
- Dimensions 16,73 x 30,94 mm

Module-No.	Type	Pitch	Pin	Dimensions (mm)
RE900-03	TSOP I	0,500 mm	20, 24	6,00 x 16,00